

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 7 年 1 月 7 日(2025.1.7)

【公開番号】特開 2023-139392(P2023-139392A)  
【公開日】令和 5 年 10 月 4 日(2023.10.4)  
【年通号数】公開公報(特許)2023-187  
【出願番号】特願 2022-44900(P2022-44900)  
【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 6 7 7 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

10

H 0 1 L 2 1 / 3 1 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

H 0 1 L 2 1 / 3 0 6 5 ( 2 0 0 6 . 0 1 )

【 F I 】

H 0 1 L 2 1 / 6 8 A

H 0 1 L 2 1 / 3 1 B

H 0 1 L 2 1 / 3 0 2 1 0 1 G

【手続補正書】  
【提出日】令和 6 年 12 月 23 日(2024.12.23)  
【手続補正 1】

20

【補正対象書類名】特許請求の範囲  
【補正対象項目名】請求項 7  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

【請求項 7】

前記モジュールを複数有する、請求項 1 から請求項 6 のいずれか一項に記載の基板処理システム。

30

40

50